

2023年 6月 27日

委員各位殿

一般社団法人 溶接学会
マイクロ接合研究委員会
委員長 福本信次
(公印省略)

【修正版】
(オンライン単独開催)

マイクロ接合研究委員会 開催通知

第142回マイクロ接合研究委員会を下記の通り「オンライン」にて開催致しますので、万障お繰り合せの上ご出席下さいますようお願い申し上げます。

出欠は6月28日(水)までに事務局へお知らせ下さい

記

1. 日 時 2023年 7月 5日(水) 13:30～16:40
2. 場 所 「Microsoft Teams」によるオンライン会議
(チームへのアクセス方法は、参加申し込み頂いた後にメールでご案内します)

◎オンライン開催のため一事業所 複数名ご参加されても無料といたします。
但し代表委員が参加者全員分取り纏めたうえで事務局へ申込をお願いいたします。
(追加・代理出席の方が個別に申込されることはお控え下さい)

3. 幹事会のご案内

同日 10:30～11:30 に幹事会を開催いたしますので、幹事または代理の方はご出席下さいますようお願い申し上げます。研究委員会とは別チームで実施します。アクセス方法は、出席でご回答頂きました幹事の方へメールでご案内します。

【出欠・事務関連の連絡先】

一般社団法人溶接学会 事務局 木暮
E-mail: s_kogure@tt.rim.or.jp TEL: 03-5825-4073

第142回マイクロ接合研究委員会
プログラム
【修正版】

日 時： 2023年 7月 5日（木） 13:30～16:40

場 所： 「Microsoft Teams」 によるオンライン会議

※開催日の接続状況や参加人数により支障が生じる可能性があります点何卒ご理解ご了承下さい。

	時 間	題 目	講 演 者
2023 年 7 月 5 日 (水)	司 会 木下 慶人（富士電機株式会社）		
	13:30～13:40	委員会議事	
	13:40～14:20	『ホットプレスによる拡散接合と製品』 (資料番号MJ-836-2023)	(株)FJコンポジット ○津島栄樹
	14:20～15:00	『銀塩焼結による大面積無垢 Cu-Cu 接合と 接合構造の高温信頼性評価』 (資料番号MJ-837-2023)	大阪大学 産業技術研究所 ○陳伝 ^{とう} 彤、菅沼克昭
	15:00～15:20	休憩	
	司 会 岩田 剛治(大阪大学)		
	15:20～16:00	『有限要素法シミュレーションの 近似器構築における演繹的・帰納的知識融合』 (資料番号MJ-838-2023)	大阪大学 ○岩田剛治
	16:00～16:40	『超音波と光干渉を用いて表層欠陥を可視化する 新しい非破壊検査技術 超音波探傷装置(MIV-X)の紹介』 (資料番号 MJ-839-2023)	(株)島津製作所 ○堀川浩司

※プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

4.オンライン開催に伴うご参加について

(参加方法について)

参加のご連絡をいただきました方に、後日 会議室番号URL、オンライン開催に関する情報を別途事務局よりご案内いたします。この情報はご参加者のみご利用をお願い申し上げます。

(配布資料について)

当日の配布資料、ご講演資料は委員会開催前にダウンロードシステムを利用し皆様へご送付致します。(これは当日欠席される方にも同様に委員全員宛にご送付いたします)

オンライン開催当日までにご自身にて配布資料の印刷を行っていただきお手元にご準備のうえご参加をお願い申し上げます。

※オンライン配信画面の撮影、録音、録画、スクリーンショットおよびその他の映像機器をご利用されての記録は絶対に行われませんようお願い申し上げます。

以上